

京写が提案する5G向け高速伝送基板

背景

近年は、電子機器市場における通信・伝送の高速化が加速度的に進んでおり、その伝送路となる回路基板には高周波の信号を損失なく伝えることが要求されています。

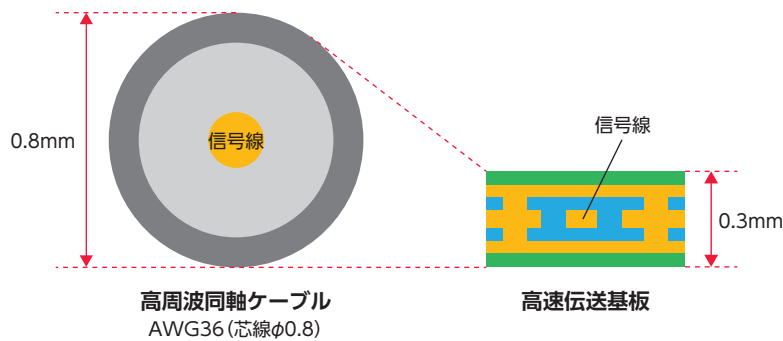
京写は、これまでに培ってきたプリント配線板のノウハウ・技術を用いて、低層基板における高速伝送基板を開発しております。

特長

- 層間絶縁材料にフッ素材料を採用し低誘電率・低誘電正接であるため、低誘電PI (ポリイミド) 製のFPC基板と比較して、伝送損失が少ない
- 同軸ケーブルと比較して、通信回路面積の削減・薄型化が可能

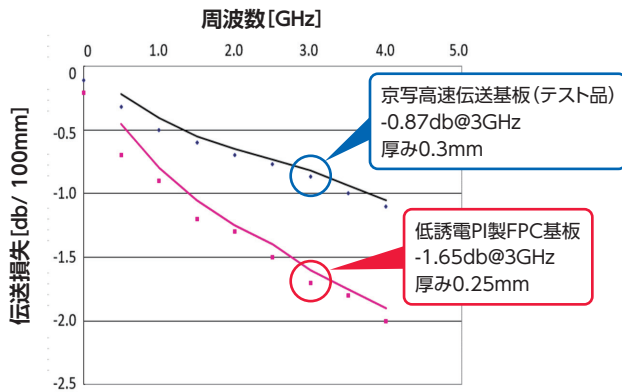
参考

同軸ケーブルとの比較



特性データ・層構成

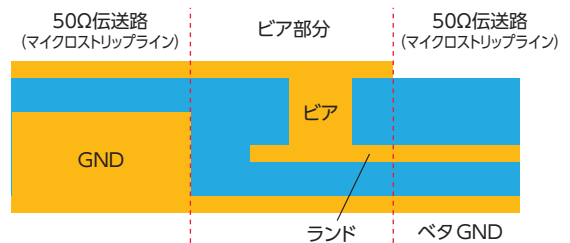
特性データ



- 測定条件: マイクロストリップライン 100mm、基板厚み 0.3mm
- 測定機器: Keysight社製 Network Analyzer ENA 4Prot 300kHz ~ 20GHz
- 開発協賛企業: 共同開発企業 第一精工株式会社様

層構成図1

※接続部分の断面図(ビア部分)



層構成図2

※基本構成: 層構成 総厚: 0.3mm以下

